**专业培训记录**

**■QMS** **□EMS** **□OHSMS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **受审核方** | | **四川光博电子科技有限公司** | | | | **专业小类/**  **项目代码** | **19.01.02** |
| **教师姓名** | | **杨珍全** | | **专业** | **19.01.02** | **培训地点** | **会议室** |
| **受培训人员** | **姓名** | **陈伟** |  |  |  |  |  |
| **专业代码** | **无** |  |  |  |  |  |
| **生产工艺/**  **服务过程** | | PCBA的加工流程：  来料检验——印刷——贴装——回流焊接——检验——入库。  关键/确认过程：焊接过程，也是特殊过程。 | | | | | |
| **生产过程/服务过程**  **的风险及控制措施**  **特殊过程的控制** | | 生产过程的风险：元器件选用不当，焊接、涂覆不合格造成产品报废风险。  控制措施：制定操作指导书，人员技能培训，设备的维护保养等  特殊过程的控制：焊接过程为特殊过程，制定操作指导书，人员技能培训，设备的维护保养等并做好出厂检验。 | | | | | |
| **重要环境及控制措施** | | **/** | | | | | |
| **不可接受风险的危险源及控制措施** | | **/** | | | | | |
| **相关法律法规的要求及产品标准** | | 相关法律法规：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益法等、中华人民共和国安全生产法。  产品标准：电子装配可接收性IPC-A-610D等。 | | | | | |
| **检验和试验项目及要求(如有型式试验要求,要进行说明)** | | **质量主要控制要求：PCB板厚度、元器件高度、焊接可靠性等。** | | | | | |
| **其它相关知识** | | **无** | | | | | |

****

**填表人(专业人员)： 日期：2020.12.26 审核组长： 日期：2020.12.26**

**注：如有其他培训内容或空格不够可另加附页**